

**第7回高機能フィルム展「フィルムテックジャパン」に出展
高機能フィルム用ミスト成膜装置「TMmist™」を展示**

東芝三菱電機産業システム株式会社(以下、TMEIC)(社長 町田精孝)は、東京ビッグサイトで4月6～8日に開催されますフィルム加工機械・材料の総合展示会である「第7回高機能フィルム展」に出展いたします。

TMEICブースでは、最先端材料をフィルム上にナノオーダーで薄膜成膜可能なミスト成膜装置「TMmist」の心臓部であるミスト発生器の実機と、実際に成膜したサンプルシートの展示を予定しております。

同展示会は、高機能フィルムおよびその成形・加工技術などあらゆるフィルム技術が一堂に出展する世界最大級の専門展です。出展企業数241社(2016年3月15日時点)、来場者数は約55,000人(2015年実績)が見込まれています。

会場にお越しの際には、ぜひ弊社展示ブースへご来臨賜りますようお願い申し上げます。

1. 展示会名	第7回高機能フィルム展
2. 場所	東京ビッグサイト 東展示棟 東6ホール、ブース番号E22-37
3. 開催日時	2016年4月6日(水)～8日(金) の3日間 10:00～18:00 (8日最終日のみ17:00終了)
4. 入場費用	事前オンライン登録により無料にて入場いただけます。 http://www.filmtech.jp/ja/ ※技術講演会(事前登録制)にご出席される場合は別途費用が必要となります。
5. 弊社展示品	<機器・サンプル展示> ○ミスト発生器 ○成膜サンプルシート <パネル展示> ○ミスト成膜装置 コンセプト ○ミスト成膜装置 一般説明 ○ミスト成膜装置 アプリケーション ○ミスト成膜装置 装置概要

* 「TMmist」は、東芝三菱電機産業システム株式会社の日本における商標です。

報道関係からのお問い合わせ先

東芝三菱電機産業システム株式会社 事業開発・広報部

〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン Tel: 03-3277-4645 Fax: 03-3277-4578

TMEIC(ティーマイク)は、社会を支える基盤である「ものづくり」の現場ニーズにお応えするために、社会の発展と美しい地球環境とを調和させる産業システムインテグレータとして、「産業」「社会」「環境」の未来を常に見据えています。工場・プラントにおいて原動力となっている回転機、電力を変換・制御するパワーエレクトロニクス、そしてプラント全体を計画し実現するエンジニアリング、これらの技術をコアに、ものづくりと環境マネジメントに最先端の技術で貢献していきます。